

2017年3月期 第2四半期決算説明会

2016年12月19日



NC 門形精密平面研削盤



I. 当社の概要

II. 当社の特徴

III. 2016年9月期 決算概況

IV. 2017年3月期 業績予想

V. 中期経営計画と進捗状況

I

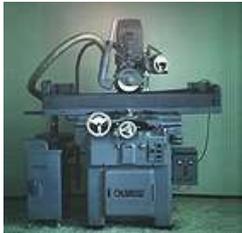
当社の概要

○ 世界唯一の総合砥粒加工機メーカー

≫ 会社概要

会社名 英文	株式会社 岡本工作機械製作所 Okamoto Machine Tool Works, Ltd.
創業	大正15年11月
設立	昭和10年6月
資本金	48億8051万円
代表者	代表取締役社長 石井 常路
本社所在地	〒379-0135 群馬県安中市郷原2993番地
事業内容	各種研削盤・半導体関連装置の製造・販売
従業員数	連結：1,813名 単体：372名 ※平成28年9月末現在
関連会社	岡本工機株式会社 技研株式会社 OKAMOTO CORPORATION(米国) OKAMOTO (SINGAPORE) PTE, LTD. (シンガポール) OKAMOTO (THAI) CO., LTD. (タイ) OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE GMBH(ドイツ)

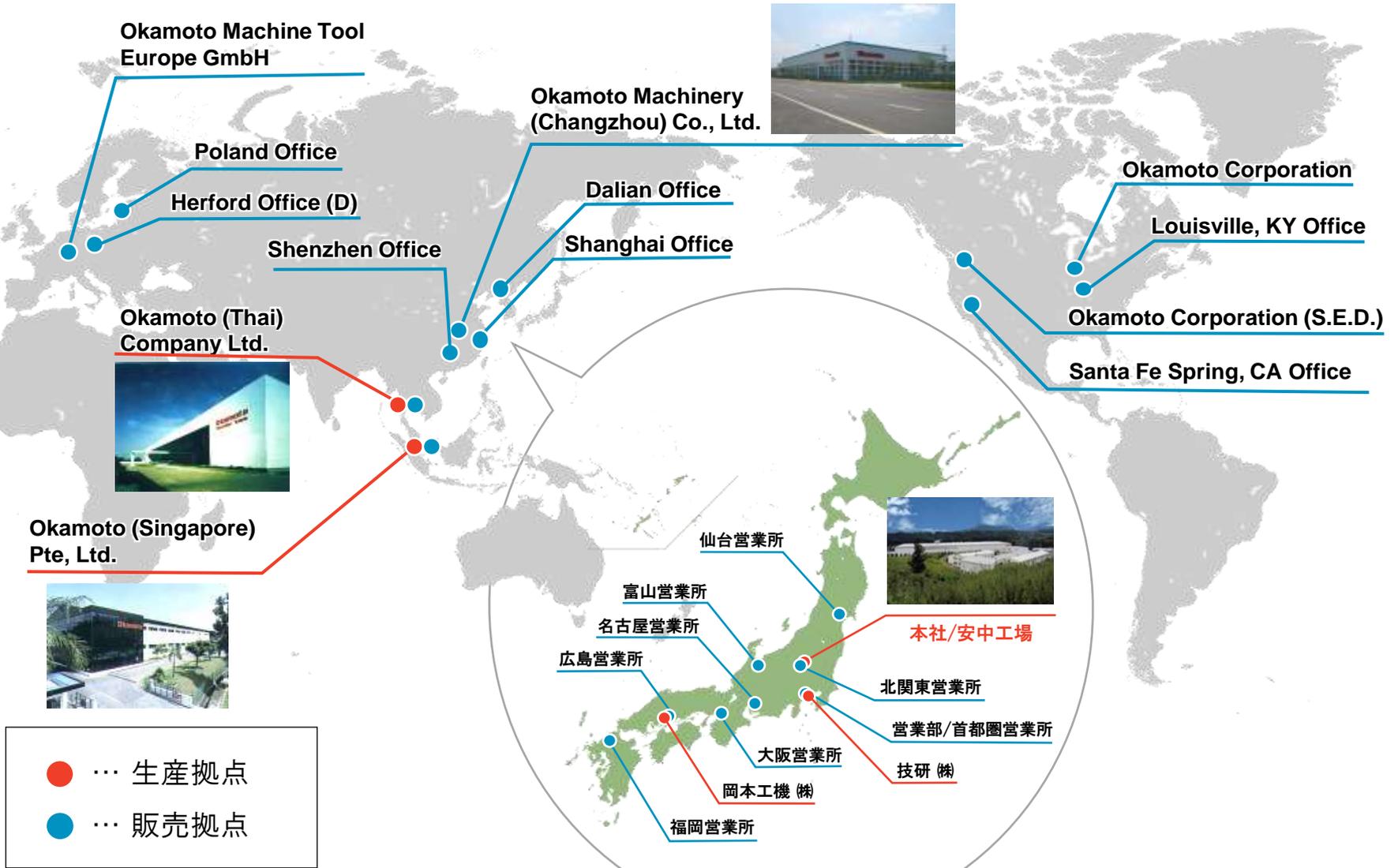


大正15年 (1926年)	岡本覚三郎が岡本専用工作機械製作所を創業
昭和5年 (1930年)	国産初の歯車研削盤 ASG-2型を完成
昭和10年 (1935年)	(株) 岡本工作機械製作所創立
昭和28年 (1953年)	国産初の平面研削盤PSG-6型完成 
昭和30年 (1955年)	国産初の外周刃スライシングマシン PSG-3GE型を完成
昭和38年 (1963年)	東京証券取引所市場第二部上場
昭和43年 (1968年)	世界初のCNC成形研削盤 NFG-5型を完成
昭和47年 (1972年)	米国に、オカモト・コーポレーション設立
昭和48年 (1973年)	シンガポール工場完成
昭和57年 (1982年)	群馬県安中市に安中工場完成
昭和61年 (1986年)	タイ工場完成
平成4年 (1992年)	ドイツに、オカモト・ヨーロッパ設立
平成8年 (1996年)	半導体事業本部を設立
平成9年 (1997年)	全自動立型高精度平面研削盤の開発で日本機械学会 技術賞受賞 全自動高精度高能率CMP装置の開発で砥粒加工学会 技術賞受賞
平成12年 (2000年)	高精度成形研削盤 UPZシリーズを完成
平成13年 (2001年)	スキヤニングポリシャーGNX300Pを完成
平成14年 (2002年)	中国・上海に駐在員事務所開設
平成16年 (2004年)	超精密平面研削盤 UPGシリーズ発売開始
平成24年 (2012年)	本社を群馬県安中市(安中工場)に移転



創業者 岡本覚三郎

○ 国内拠点、海外拠点



○ 具体的施策 岡本工機 高精度歯車生産の主力拠点

Okamoto
岡本工機株式会社



1926年	岡本覚三郎が、岡本専用工作機械製作所を創業
1935年	㈱岡本工作機械製作所、と組織及び社名を変更
1944年	㈱岡本工作機械製作所 松永工場、を設立。平歯車、傘歯車の生産と歯切盤の製造を開始
1960年	傘歯車の生産工場落成
1973年	販売体制強化のため歯車製造部門を、㈱岡本工作機械製作所より分離 岡本歯車㈱を設立
1975年	工作機械製造部門を、㈱岡本工作機械製作所より分離 岡本工機㈱を設立し広島県尾道市長者原に移転
1986年	岡本歯車㈱と岡本工機㈱が合併し、岡本工機㈱となる 本社を広島県福山市金江町に移転 資本金 1億6,700万円となる
1989年	本社工場増築 歯車部門倍増となる
1992年	尾道工場増築
1993年	資本金 3億2,200万円に増資
1994年	本社工場 NC傘歯車歯切盤120台増設
1995年	尾道工場 歯車部門増設
1997年	ガス浸炭窒化炉(スベリア式バッチ型)2基新設
1998年	松永工場 ギヤブランク生産体制強化
2000年	尾道工場 刈払機ASSY体制強化
2003年	JIS Q9001:2000 (ISO9001:2000)取得
2004年	岡本工機(常州)有限公司を設立
2013年	岡本工機(常州)工作機械の輸入販売開始(岡本工作機械製品)



社名	岡本工機株式会社
代表者	代表取締役社長 菊地 正人
設立	1975年5月
資本金	3億2,200万円
従業員	220名

○ 岡本工機 前期 新工場・用地建物取得

背景

自動車業界の新車・新技術開発に係る設備投資の活況
政府のロボット産業に対する手厚い振興策の継続

「高精度歯車」への受注・引合 高水準

北川精機より広島・府中工場の工場用地・建物を取得

(土地面積 21,175平米、建物面積 7,435平米、取得金額 6億7000万円)



府中工場（現状）



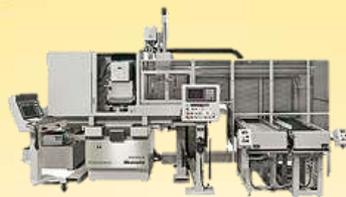
Okamoto
岡本工機株式会社



各種歯車の生産能力を50%向上

(速やかな本格稼働を目指し作業進行中)

3年後売上高を現状40億円から60億円に引き上げを期す



平面研削盤



門型研削盤



円筒研削盤



歯車研削盤



内面研削盤



9.6mピッチポリッシャー



5mラップ盤



スライサー



ラップ盤



ポリッシャー



グラインダー



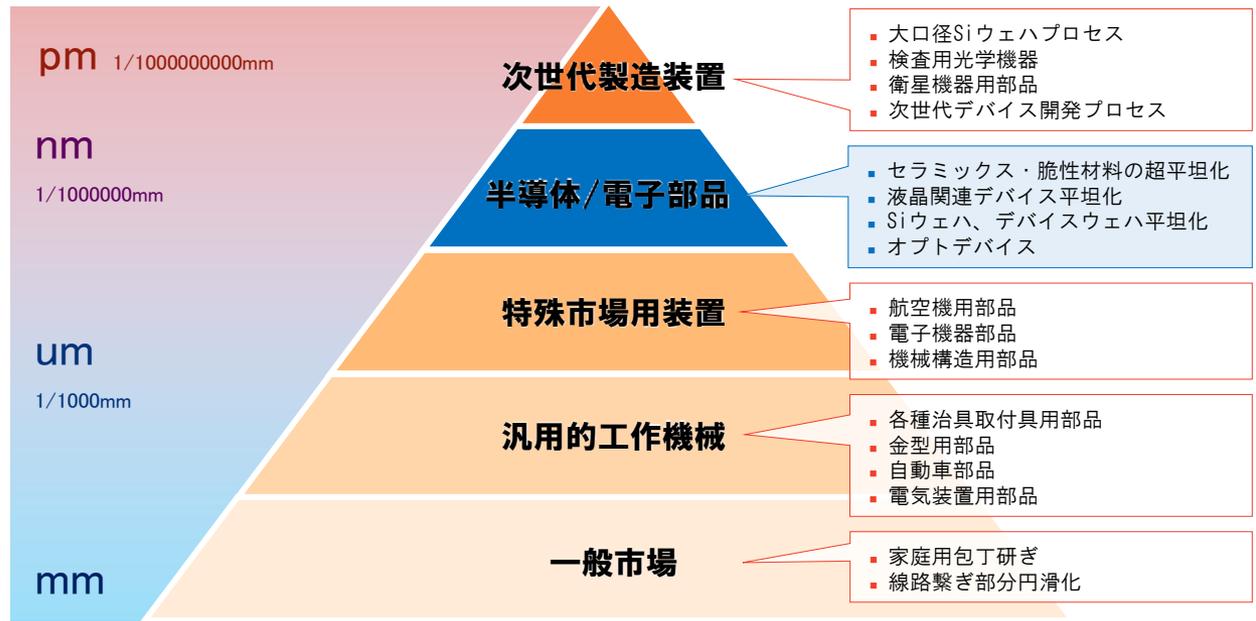
ファイナル
ポリッシャー

金属加工機 = 工作機械

ピッチポリッシャー
超大型ラップ盤

脆性材加工機 = 半導体製造装置

○ あらゆるニーズへの対応～ 豊富な機種構成



- 大口径Siウエハプロセス
- 検査用光学機器
- 衛星機器用部品
- 次世代デバイス開発プロセス



- セラミックス・脆性材料の超平坦化
- 液晶関連デバイス平坦化
- Siウエハ、デバイスウエハ平坦化
- オプトデバイス



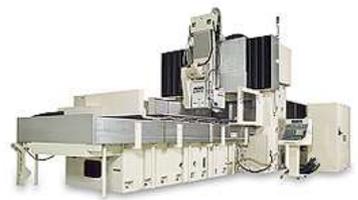
- 航空機用部品
- 電子機器部品
- 機械構造用部品



- 各種治具取付具用部品
- 金型用部品
- 自動車部品
- 電気装置用部品



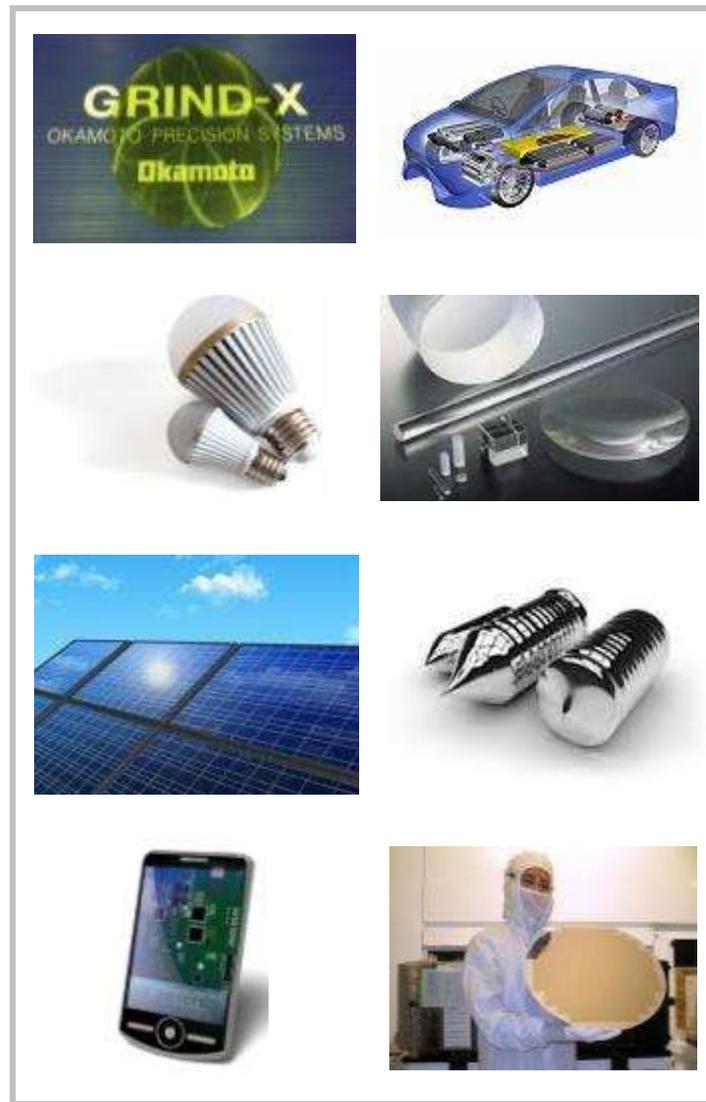
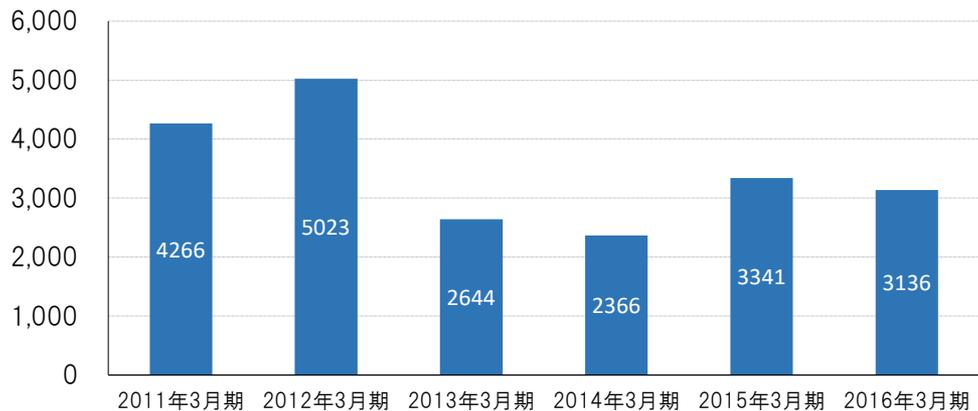
- 家庭用包丁研ぎ
- 線路繋ぎ部分円滑化



○ 半導体製造装置事業の状況

売上高

(単位:百万円)



○ 半導体製造装置の機種別分類: 主力製品

6000万円



GNX200B
SiCウェーハ用グラインダー



次世代パワー半導体SiC
電気自動車、電車、PC
他

15000万円



GDM300
ウェーハ薄化用
インライングラインダー



スマートフォン
PC
他

23000万円



SPP800ATB
バッチ式ウェーハポリッシャー



スマートフォン
SAWフィルター

○ 半導体製造装置の機種別分類：関連製品

7000万円



SiSG156HT
太陽電池インゴット複合研削盤



太陽電池・ソーラーパネル

20000万円



PSG-CHシリーズ
門形平面研削盤



SPP3800
ピッチポリッシャー



液晶(LCD)テレビ・ディスプレイ

II

当社の特徴

○ 当社の5つの特徴

- 1 **グローバルな販売網**
- 2 **タイ・シンガポール・アジアでの生産拠点の充実**
- 3 **一貫生産体制**
- 4 **伝統に裏打ちされた高い技術力**
- 5 **豊富な機種構成、幅広い客層、高い顧客対応力**

1 グローバルな販売網

Okamoto Machine Tool Europe GmbH



Okamoto Machine Tool (Shanghai) Office



Okamoto (Thai) Company Ltd.

Okamoto (Singapore) Pte, Ltd.



Okamoto Corporation

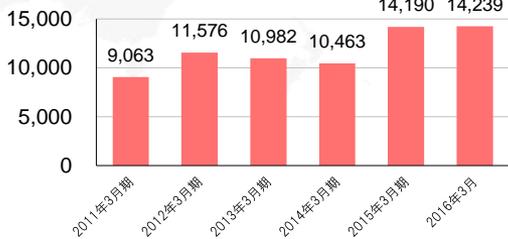
(単位:百万円)

アジア



(単位:百万円)

日本



(単位:百万円)

北米



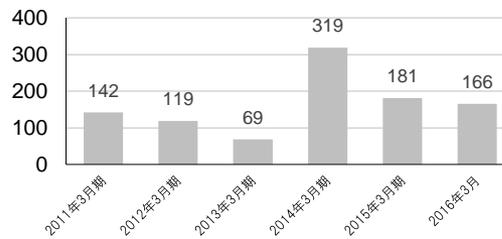
(単位:百万円)

欧州



(単位:百万円)

その他



② タイ・シンガポール・アジアでの生産拠点① ～ シンガポール



OKAMOTO(SINGAPORE) PTE, LTD

10 Riverside Road, Singapore 739082, Republic of Singapore

TEL : 65-62696426

FAX : 65-62690832

<http://www.okamoto.com.sg/>



1973年12月	設立
1981年6月	第1次工場増築
1986年3月	第2次工場増築
1991年9月	第3次工場増築
1994年6月	ISO9002取得(アジア地区の工作機械業界初)
2007年2月	ISO14001取得

② タイ・シンガポール・アジアでの生産拠点② ～ タイ



OKAMOTO (THAI) COMPANY LTD.

174 Mu 2, Tambol Chamaeb, Amphur Wangnoi, Ayudthaya 13170, Thailand

TEL : 66-35-271187 ~ 90 FAX : 66-35-271191

<http://www.okamotothai.com/>

1987年12月	設立
2004年11月	ISO9001取得
2005年2月	ISO14001取得
2005年9月	新組立工場完成
2006年8月	鋳物工場完成
生産品目：鍛造品、鋳物、小型平面研削盤	



3 一貫生産体制



安中工場



基幹工場
(徹底した温度管理、クリーンルーム)

シンガポール

精密加工機的设计・生産

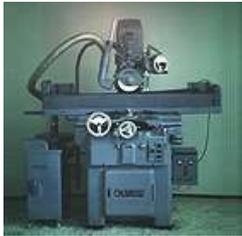


タイ

鑄物の生産、一般機の量産



4 伝統に裏打ちされた高い技術力

大正15年 (1926年)	岡本覚三郎が岡本専用工作機械製作所を創業	
昭和5年 (1930年)	国産初の歯車研削盤 ASG-2型を完成	
昭和10年 (1935年)	(株) 岡本工作機械製作所創立	
昭和28年 (1953年)	国産初の平面研削盤PSG-6型完成	
		
昭和30年 (1955年)	国産初の外周刃スライディングマシン PSG-3GE型を完成	
昭和38年 (1963年)	東京証券取引所市場第二部上場	
昭和43年 (1968年)	世界初のCNC成形研削盤 NFG-5型を完成	
昭和47年 (1972年)	米国に、オカモト・コーポレーション設立	
昭和48年 (1973年)	シンガポール工場完成	
昭和57年 (1982年)	群馬県安中市に安中工場完成	
昭和61年 (1986年)	タイ工場完成	
平成4年 (1992年)	ドイツに、オカモト・ヨーロッパ設立	
平成8年 (1996年)	半導体事業本部を設立	
平成9年 (1997年)	全自動立型高精度平面研削盤の開発で日本機械学会 技術賞受賞 全自動高精度高能率CMP装置の開発で砥粒加工学会 技術賞受賞	
平成12年 (2000年)	高精度成形研削盤 UPZシリーズを完成	
平成13年 (2001年)	スキャニングポリシャーGNX300Pを完成	
平成14年 (2002年)	中国・上海に駐在員事務所開設	
平成16年 (2004年)	超精密平面研削盤 UPGシリーズ発売開始	
平成24年 (2012年)	本社を群馬県安中市(安中工場)に移転	

© 2016年8月31日

JST（国立研究開発法人科学技術振興機構）実施の「研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）」における「ステージIII（NexTEP-A）タイプ」の新規課題に半導体関連装置開発部門応募の「Si貫通電極ウエハー全自動化装置」の採択が決定

1. 「研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)」の目的

大学・公的研究機関等で生まれた国民経済上重要な科学技術に関する研究成果を基に、実用化を目指す研究開発フェーズを対象とした技術移転支援プログラム

2. 採択された事業

「Si貫通電極ウエハー全自動薄化加工装置」

3. 事業支援期間

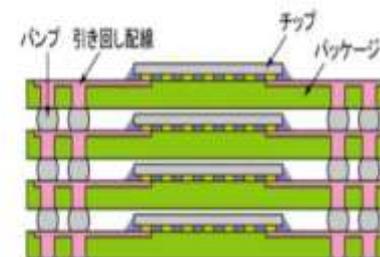
事業支援予定期間： 2016年10月～2020年9月まで

(a) チップ積層型3次元集積回路



- ・小型
- ・高速
- ・消費電力が小さい

(b) パッケージ積層型3次元集積回路



- ・大型
- ・低速
- ・消費電力が大きい

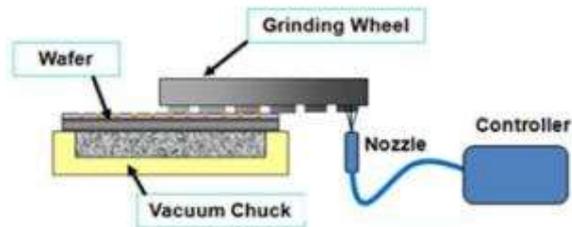
4 JST新規課題採択 Si貫通電極ウェーハ全自動薄化装置②

本技術の背景と採択技術の概要

- ◆ Si貫通電極(TSV)技術は、あらゆる3次元集積回路の積層時の電氣的接続を実現する為のキーテクノロジーであり、低コスト化と高歩留り化が本技術における最大の課題
- ◆ そこで世界中が不可能と考えられていた新規技術/装置を開発し、課題解決への寄与を目指す

本技術の概要とその特徴

- ◆ Cu/Si同時研削技術
 - ▶ 高圧水による砥石のCu目詰まり除去方法の確立 (特許第5671510号)
- ◆ Cu汚染除去技術
 - ▶ Cu汚染の複合的な除去プロセスの確立 (特許第5827277号)
- ◆ Si面内厚さ分布自動補正機能付き研削技術
 - ▶ インプロセス測定に連動した適応制御による高精度研削の確立 (特願2013-149245)



Cu/Si同時研削

① 強アルカリイオン水洗浄



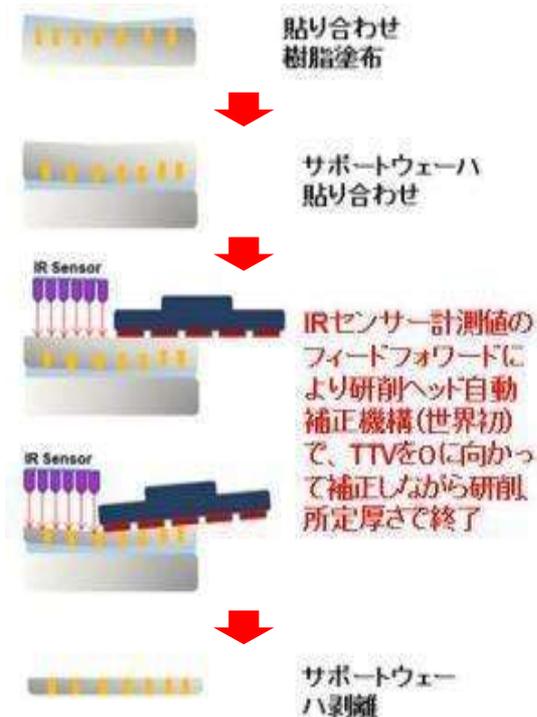
② Ni-B無電解めっき(Cuキャップ)



③ Siアルカリエッチング(Cu汚染除去)



Cu汚染排除



Si面内厚さ分布自動補正

4 JST新規課題採択 Si貫通電極ウェーハ全自動薄化装置③

▶▶ 本装置で変わる3次元集積回路市場

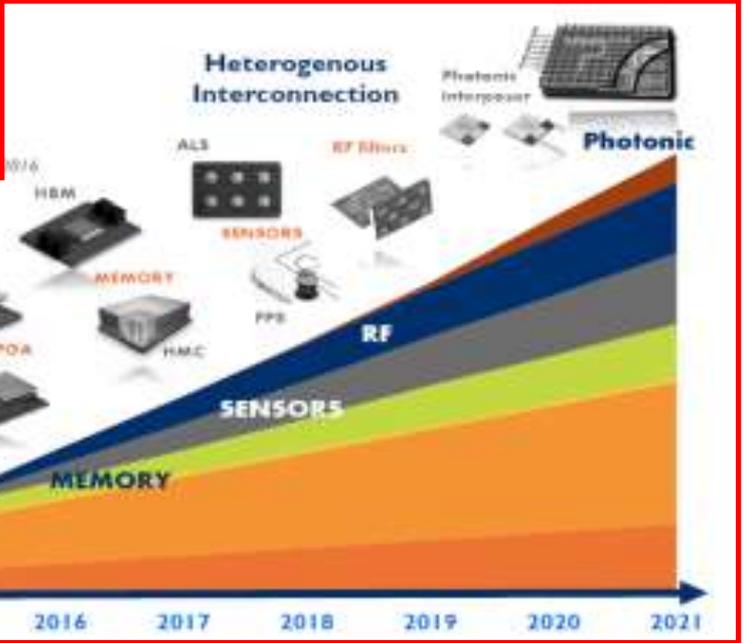
- ◆ 当該技術の確立によって、これまでのSi貫通電極ウェーハを上回る極薄デバイスの製作が可能となることにより、装置/プロセスコストが大幅に削減
- 
- ◆ デバイスの高速化・低電力化・小型軽量化が達成されることにより、モバイル機器をはじめとする各種デバイス市場が変革され、ハイエンドからローエンドまでのあらゆる電子機器に本技術が搭載

▶▶ 本技術が搭載された新規開発装置の将来性/市場性予想

- ◆ 本技術(装置)を適用する事で、SIP(システムインパッケージ)が加速し、3次元集積回路の大幅な需要増加が見込める。
各種デバイスの生産量は4000万枚～5000万枚/年(300mmウェーハ)が予測されているが、その中の20%が本技術を使った3次元集積化回路になった場合には、新たに100台以上の当該装置が必要となる想定。

④ JST新規課題採択 Si貫通電極ウェーハ全自動薄化装置④

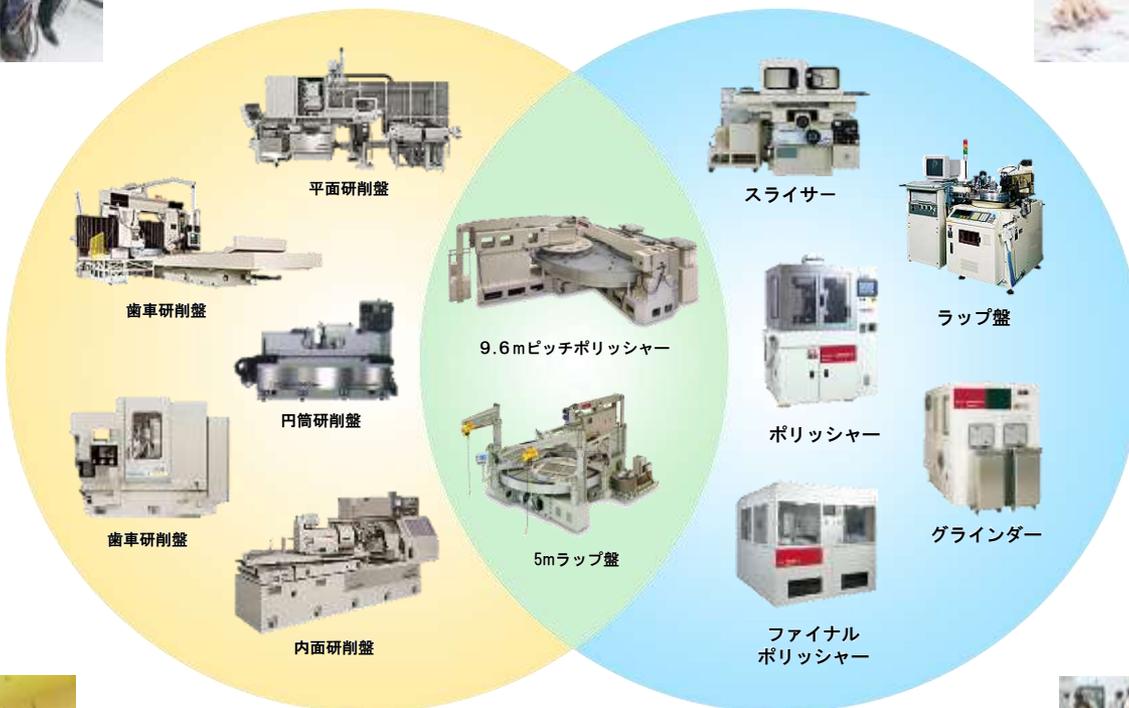
▶▶ 本技術が使われる各種電子製品群



(資料出展: 共にYole Development)

▶▶ 各種3次元デバイスの成長予測

5 豊富な機種構成、幅広い顧客、高い顧客対応力



III

2016年9月期決算概況

○ 2016年9月期の市場環境

【国内市場】

- ものづくり補助金など政府の支援策の効果もあり工作機械は前年同期比微増
特に注力している高付加価値製品が順調に推移
- 歯車、鋳物は大口先の受注が戻らず引き続き売上は低迷。
歯車についてはロボット用歯車は順調に推移
- 半導体はポリッシュ盤の販売好調など大口案件を取り込み計画を上回る数字に

【海外市場】

- 北米は大統領選の影響等から設備投資に慎重な姿勢も見られ低調に推移
- 欧州は英国のEU離脱の影響はあるものの、ドイツ市場は堅調
- アジア市場は中国の景気減速の影響で設備投資は停滞、受注、売上とも低調ながら、半導体について大口案件を成約

業績ハイライト

(単位:百万円、%)

	2015年9月	2016年9月	
	金額	金額	前期比増減率
売上高	12,414	10,909	-12.1%
売上総利益	3,503	3,278	-6.4%
販売費及び一般管理費	3,060	2,912	-4.9%
営業利益	442	366	-17.2%
経常利益	378	135	-64.3%
当期純利益	177	63	-64.1%

※小数点第2位を四捨五入

(単位:百万円)

	2016年3月	2017年3月 (予想)
	金額	金額
設備投資額	1,456	1,602
減価償却費	1,234	1,224
研究開発費	62	135
為替レート	2016年3月	2016年9月
米ドル	120.16	105.39
シンガポールドル	86.72	77.56
ユーロ	132.53	117.69
タイバーツ	3.42	3.01
人民元	18.84	15.90

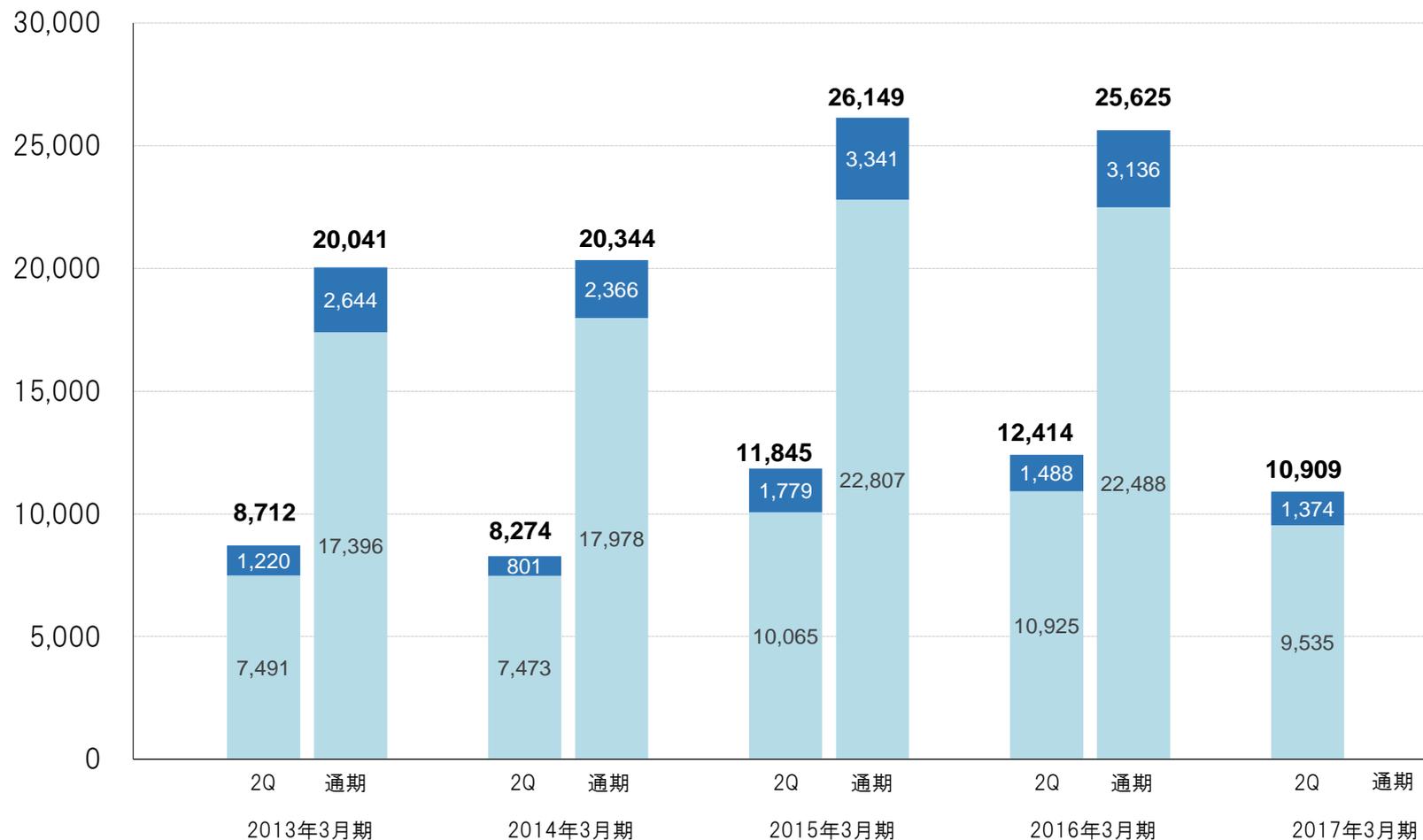
※期中の平均レートで記載しております。

- 売上は前期比12%減少。ただし利益は中期経営計画に沿った変動費、固定費の削減が効いて概ね計画通りの数字を確保。特に変動費はQCD活動による変動費改善が目標を超えて順調に推移。
- 工作機械は今年度よりものづくり補助金など政府支援策の影響もあり、前年同期比売上は微増。中期経営計画施策に沿った形で高付加価値製品は順調に推移。一方で大手ユーザーへの販売が低迷し、鋳物、歯車は引き続き低調。ただしロボット用歯車などには明るさ。
- 半導体は前期より市場回復が続き底堅く推移。ポリッシュ盤が国内、海外で販売好調のほか、海外向けバックグラインダーなども堅調に推移。

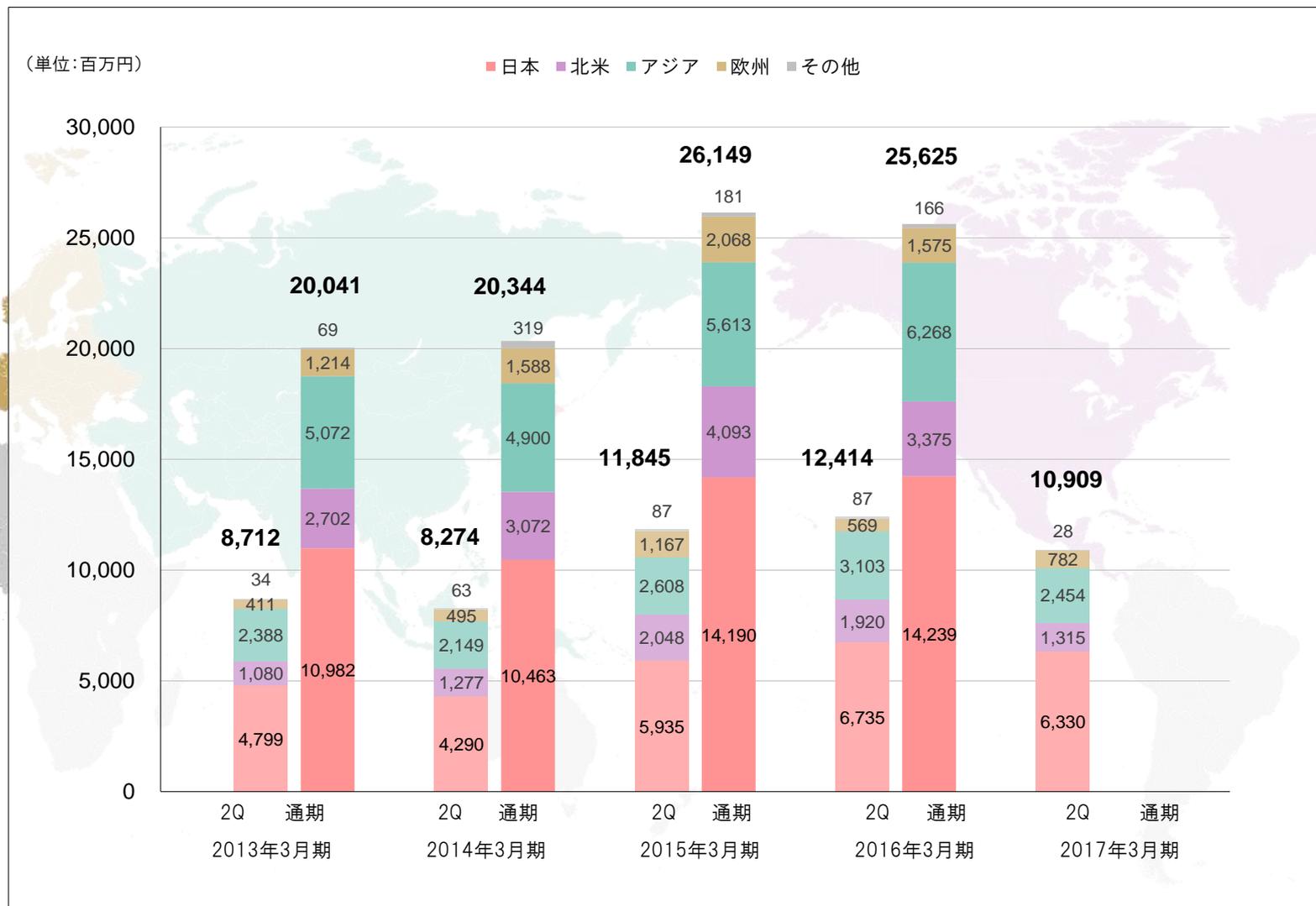
セグメント別売上高推移

(単位:百万円)

■ 工作機械 ■ 半導体関連装置

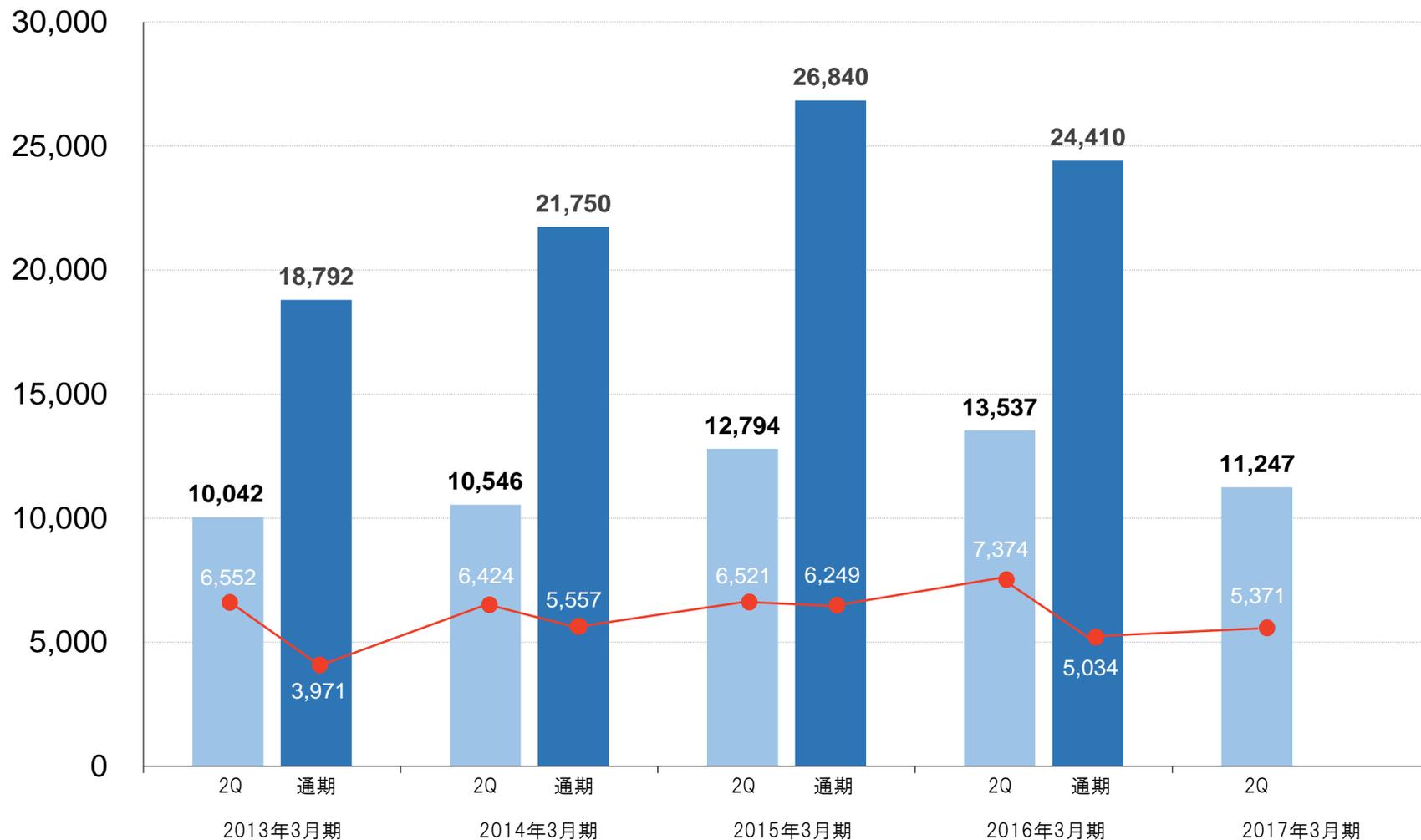


○ エリア別売上高推移



○ 受注・受注残高推移

(单位:百万円)



○ 比較貸借対照表

(単位:百万円)

	2016年3月	2016年9月	
	金額	金額	対前期末比
流動資産	18,055	16,378	▲1,677
現金及び預金	3,961	3,793	▲168
受取手形及び売掛金	7,304	5,584	▲1,720
棚卸資産	6,343	6,466	123
有形・無形固定資産	9,165	8,732	▲433
投資等	437	437	0
資産合計	27,658	25,548	▲2,110

(単位:百万円)

	2016年3月	2016年9月	
	金額	金額	対前期末比
負債合計	18,618	17,279	▲1,339
流動負債	14,030	13,305	▲725
固定負債	4,587	3,973	▲614
純資産合計	9,039	8,269	▲770
負債資本合計	27,658	25,548	▲2,110

<総資産(前期末比▲2,110m)>

- 流動資産の減少 ▲1,677m
- ・受取手形・売掛金の減少 ▲1,720m … 売掛金回収により減少及び売上の減少
- ・現預金の減少 ▲168m
- 有形・無形固定資産の減少 ▲433m … 減価償却による減少▲588m

<負債(前期末比▲1,339m)>

- 借入金の減少 ▲1,305m … (連結)調達/+500m ⇄ 返済/▲1,539m

<純資産(前期末比▲770m)>

- 当期純利益 +63m、為替換算調整勘定 ▲700m
- 配当金の支払い ▲132m → 自己資本比率は32.4%

○ 比較キャッシュフロー計算書

(単位:百万円)

	2016年3月		2016年9月	
	金額		金額	対前期末
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,064		1,629	▲435
税引前当期純利益	967		168	▲799
減価償却費	1,234		588	▲646
売上債権の増減 (▲は増加)	413		1,491	1,078
棚卸資産の増減 (▲は増加)	536		▲486	▲1,022
仕入債務の増減 (▲は減少)	▲431		16	447
その他	▲657		▲149	508
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲1,437		▲346	1,091
財務活動によるキャッシュ・フロー	784		▲1,219	▲2,003
換算差額	▲139		▲175	▲36
現金・同等物残高	3,510		3,398	▲112

■ 現金・同等物は、前期末比▲112m減の3,398m

- 営業CF +1,629m
 - ・売上債権の減少 +1,491m …… 売上債権回収による減少及び売上の減少
- 投資CF ▲346m
 - ・設備投資 ▲381m …… 引き続き岡本工機新工場関連の投資など
- 財務CF ▲1,219m
 - ・借入金の減少 ▲939m

IV

2017年3月期 業績予想

○ 来期業績予想

2017年3月期 予想数字は不変

(単位:百万円、%)

	2016年3月	2017年3月	
	金額	金額	前期比増減率
売上高	25,625	25,000	-2.4%
売上総利益	7,457	7,500	+0.6%
販売費及び一般管理費	6,230	6,500	+4.3%
営業利益	1,226	1,000	-18.5%
経常利益	971	700	-27.9%
当期純利益	561	400	-28.7%

※小数点第2位を四捨五入

(単位:百万円)

	2016年3月	2017年3月
	金額	金額
設備投資額	1,456	1,602
減価償却費	1,234	1,224
研究開発費	62	135
為替レート		
	2016年3月	2017年3月
米ドル	120.16	110
シンガポールドル	86.72	80
ユーロ	132.53	124
タイバーツ	3.42	3.18
人民元	18.84	17

※期中の平均レートで記載しております。

○ 2017年3月期の市場環境見通し

【国内市場】

- 政府施策にも支えられて引き続きロボット関連の投資は活発。自動車、航空機、医療器関連の投資も堅調さを維持

【海外市場】

- 北米は大統領選が終了。結果的には、トランプ新政権への期待から引き続き好景気を予想
- 中国は未だ景気が低迷も、引き続き高精度、自動化対応の要求は高い状況

【半導体】

- 上期好調だった半導体関連装置は堅調さを維持



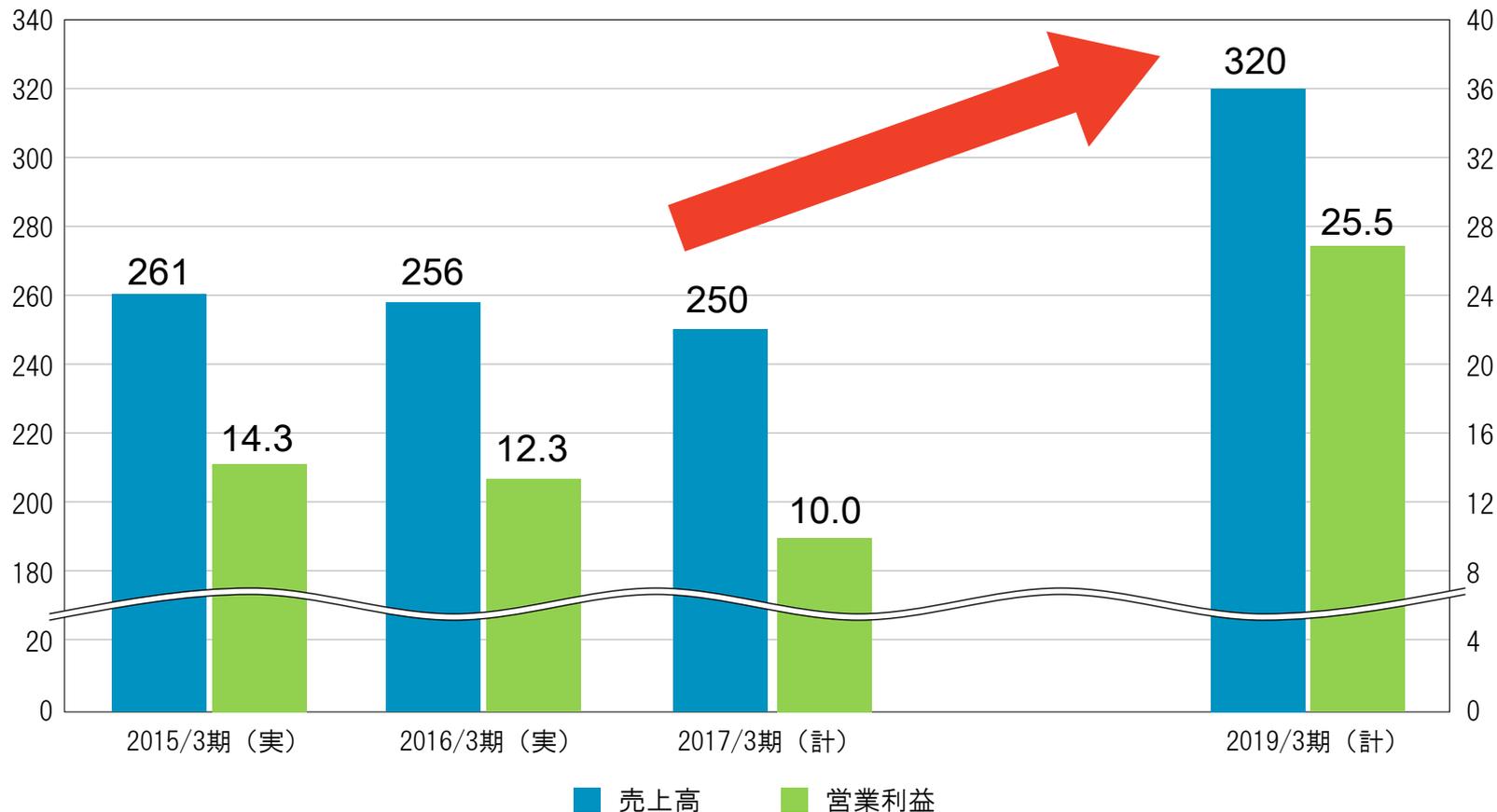
中期経営計画と進捗状況

Mission GX2019

○ 中期目標

売上高 億円

営業利益 億円



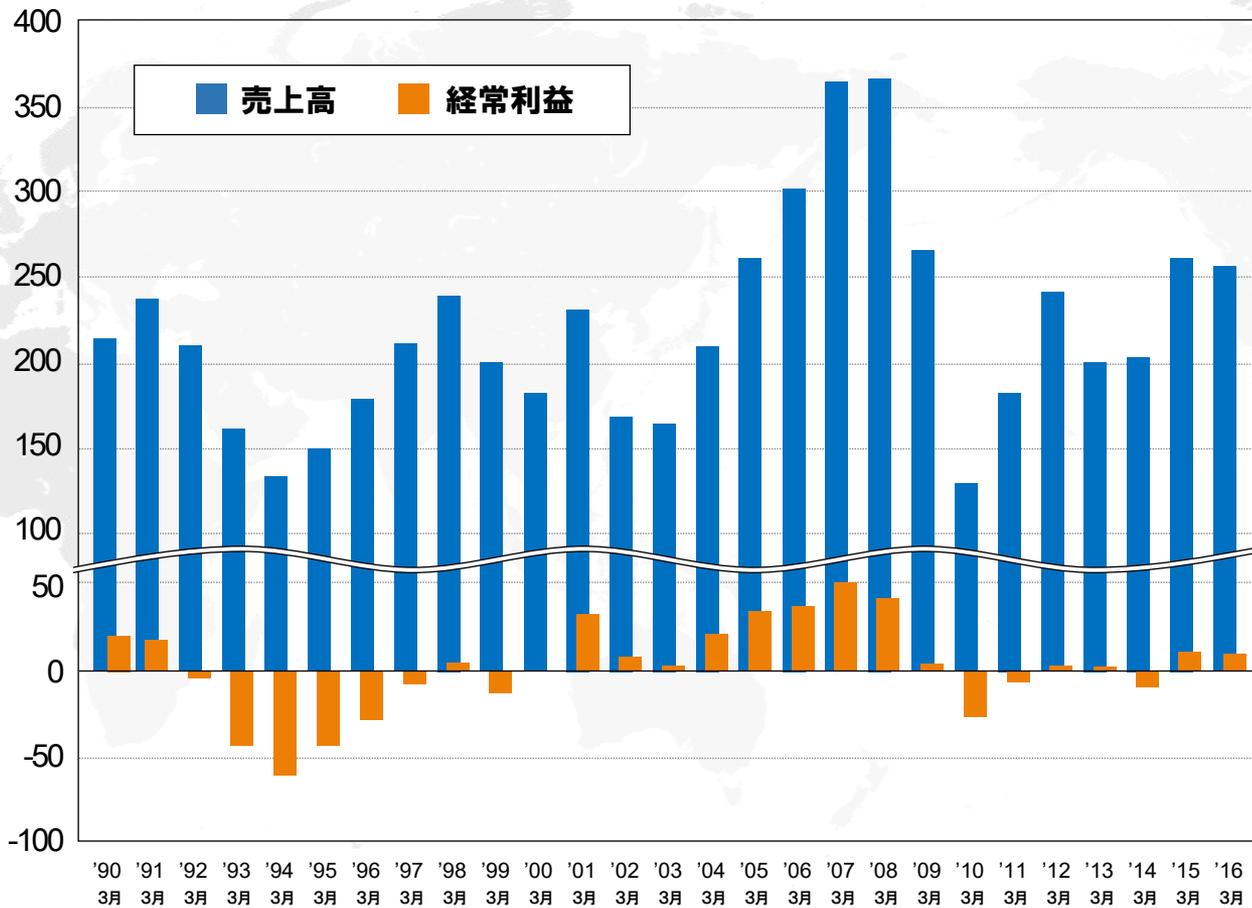
営業利益率目標 8%

海外売上高比率 60%

○ 中長期業績推移

(億円)

1990年以降の売上高・経常利益推移



	売上高 (億円)	経常利益 (億円)
1990年3月	214.51	19.82
1990年3月	214.51	19.82
1991年3月	237.92	17.13
1992年3月	209.95	-4.02
1993年3月	161.47	-43.11
1994年3月	133.57	-59.55
1995年3月	149.65	-42.98
1996年3月	178.92	-27.94
1997年3月	211.16	-7.46
1998年3月	239.58	4.29
1999年3月	200.6	-13.21
2000年3月	182.09	-0.87
2001年3月	231.15	32.05
2002年3月	168.7	7.92
2003年3月	164.42	2.95
2004年3月	209.89	20.82
2005年3月	261	34.02
2006年3月	301.69	36.04
2007年3月	364.2	49.76
2008年3月	366.32	40.82
2009年3月	265.92	3.39
2010年3月	129.34	-26.42
2011年3月	182.48	-6.7
2012年3月	241.51	2.71
2013年3月	200.41	2.35
2014年3月	203.44	-9.25
2015年3月	261.49	10.35
2016年3月	256.3	9.71

○ 弊社を取り巻く環境

国内市場

政府主導の経済政策の継続により各方面の設備投資は堅調

受注、引合とも引き続き堅調に推移
特に当社と関係の深い、航空機、自動車業界からの受注、引合は堅調を維持

海外市場

中国経済減速、中東での政情不安、米国の利上げ等 先行き不透明感



米国

活発な設備投資に少し陰り
市場規模は大きく、高付加価値機に対する需要あり



中国

引合件数に陰りがみられるが、
自動化、高精度化への関心は強い

○ 具体的施策 海外販売の強化

米国と中国を戦略拠点と位置づけ販売を強化

米国

- ◆ 汎用機中心から大型機、高付加価値機の拡販
- ◆ 日本市場に投入している高精度・高能率仕様、アプリケーションの横展開を図る
- ◆ 営業拠点の増設（現在4拠点 → 中期計画期間中に北東部に拠点創設 → 5拠点体制へ）

中国

- ◆ 小型成形研削盤の拡販を継続しつつ、大型機、高付加価値も拡販
- ◆ 日本市場に投入している高精度・高能率仕様、アプリケーションの横展開（人件費高騰、産業の高度化により高効率、省力化の要求あり）
- ◆ 営業拠点の増設（現在4拠点 → 中期計画期間中に内陸（武漢）、北京、東莞に拠点創設 → 6～7拠点体制へ）

○ 具体的施策 海外販売の強化 今期進捗状況

ショールームへ大型機・高付加価値機を設置へ

米国

- ◆ 大型機をショールームに常設し、常時デモ、テスト研削ができる体制へ。販売も既に3台納入と好調な立ち上がり
- ◆ 北東部市場専任営業担当者を採用。11月より活動スタート

中国

- ◆ 高付加価値機としてNC機をショールームに常設。テスト研削への対応可能に。販売実績も既に5台納入と好調な立ち上がり
- ◆ 拠点増設は景気減速を受け慎重に1年保留も、当該エリアでの営業員採用活動は進行中

○ 中期事業計画の骨子 ～ 技術・生産

◎ 技術・生産他

施策

- ① 品質向上
- ② 平準化
- ③ サービス体制の強化
- ④ コストダウン
- ⑤ 効率化

その為の 具体施策

1. QCD改善活動を通じ変動費を削減する

- ・初期クレームの撲滅
- ・資材調達機能強化(グローバル調達含む)
- ・平準化と生産性向上による内製化の推進

2. 規格・モジュール化推進による品質の向上とコストダウン

3. 3D CAD化推進による設計効率化と品質の向上

4. 集中サービスセンターによるパーツ即納体制を確立

5. 歯車生産のライン化、自動化による、品質安定、効率化

6. 管理系システム再構築による効率化、品質向上



○ 中期事業計画の骨子 ～ 技術・生産 進捗状況①

特にQCD改善活動による変動費削減に成功

1. QCD改善活動を通じた変動費の削減

Q(品質)、C(コスト)、D(納期)

・初期クレームの撲滅

118期目標:クレーム対策費用削減(前期比20%削減)⇒上期実績は計画通り

・資材調達機能強化(グローバル調達含む)

118期目標:5000万円削減 ⇒上期実績は計画を上回り削減

・平準化と生産性向上による内製化の推進

118期目標:前期比8%の内製金額増加⇒上期計画を若干下回るも通期では計画達成見込み

○ 中期事業計画の骨子 ～ 技術・生産 進捗状況②

モジュール化、3D CAD化などの推進も順調に進捗

2. 規格・モジュール化推進による品質の向上とコストダウン

- ・社内標準規格を見直し、適時最新アップデートを行えるデータシステムの構築
- ・主要平面研削盤シリーズCA、CHシリーズにおいて、ユニットモジュールを使うことで構造の選択を容易にし、後工程を簡素化できる設計スタイルを構築

3. 3D CAD化推進による設計効率と品質の向上

- ・旧2D画面から3Dへの推進プロジェクトを実行中
- ・3D解析ソフトによる効率化設計の適用

4. 集中サービスセンターによるパーツ即納体制を確立

- ・パーツのストア化促進とインフラ整備及びサービス員増員とローテーション実施

○ 具体的施策 戦略機種への投入

戦略機種を開発し、海外市場へ投入する

▶▶ 複合研削盤(円筒研削盤ベース)

ヨーロッパ競合が成功している「円筒研削盤の複合機」の機能・性能を取り入れて、市場拡販を押し進める。

国内競合メーカーが先行したが、価格・機能で市場ニーズを満たしていないので、ヨーロッパ市場で磨きを掛けて逆輸入拡販を図る。



▶▶ サドル型、コラム型中型平面研削盤の新シリーズ

ロングセラー商品であるサドル型中型平面研削盤のモデルチェンジを通じて競争力を強化する



▶▶ 大型平面研削盤のコストダウン機

国内でベストセラーシリーズに成長した高剛性大型平面研削盤の生産を海外に移管し、コストダウンを通じて競争力を強化し拡販につなげる



機種統廃合による製品ラインナップの再構築にも注力

○ 具体的施策 戦略機種への投入

複合研削盤、サドル型、コラム型新シリーズの投入進む

≫ 複合研削盤(円筒研削盤ベース)

市場投入に向け急ピッチで開発中。9割程度の開発段階。
既に見本市には上市可能に。



≫ サドル型、コラム型中型平面研削盤の新シリーズ

市場投入に向け急ピッチで開発中。9割程度の開発段階。



≫ 大型平面研削盤のコストダウン機

市場投入に向け鋭意開発中。なお、上市まではステップあり。



究極の
平面創成



Okamoto

本資料に関するお問い合わせ先

株式会社 岡本工作機械製作所
総務部
TEL 027(385)5800

【本資料お取り扱い上のご注意】

本資料は、株式会社岡本工作機械製作所(以下、当社)をご理解いただくため、当社が作成したもので、当社への投資活動勧誘を目的としておりません。

本資料を作成するにあたっては正確性を期すために慎重に行っておりますが、完全性を保証するものではありません。本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。

本資料中の業績予測ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果があります。